

附件

2025 年度第二批昆山市双创人才计划 拟立项项目名称

(排名不分先后)

| 序号 | 项目名称 |
|----|--|
| 1 | 新一代轻量化高强度热塑复材结构件的研发及产业化 |
| 2 | 多模多频可重构卫星通信导航一体化 SoC 芯片的研发及产业化 |
| 3 | 基于光驱一体 Chiplet 架构的 micro-LED 芯片的研发及产业化 |
| 4 | 大面积钙钛矿/晶硅叠层组件量产技术开发 |
| 5 | 算力中心液冷创新技术研发与装备产业化 |
| 6 | 基于氩气霍尔电推的空间推进器研发及产业化 |
| 7 | 量子计算用大冷量稀释制冷机的研发 |
| 8 | 跨临界 CO2 单压双级制冷式环境试验设备研发及产业化 |
| 9 | 高比能经济型锰系全固态电池的关键技术开发及产业化 |
| 10 | 基于真空工艺的先进封装技术开发 |
| 11 | AI 融合仿真计算致速固态电池研发与产业化 |
| 12 | 应用于新一代智能制动系统模块用连接器总成的研发及产业化 |
| 13 | 高精度操作机器人关键硬件及系统集成产业化 |
| 14 | 高性能抗硫化贴片电阻技术的研发及产业化 |
| 15 | 超高耐性复合硅橡胶基半导体封装等领域关键材料研发及产业化 |

| | |
|----|---|
| 16 | 低成本高低轨融合宽带卫星通信终端研发及产业化 |
| 17 | 中大型复合翼无人机总体设计方法研究 |
| 18 | 新一代远红外高端工业检测系统及高端制造产业化 |
| 19 | 高速运算电子元件用环氧电子胶黏剂的开发 |
| 20 | 钙钛矿/硅二端叠层技术及量产设备的研发及产业化 |
| 21 | 基于 PVD 技术真空镀膜设备的研发及产业化 |
| 22 | 芯片封装高性能热界面材料的研发及产业化 |
| 23 | 漆包石墨烯铜线的关键技术研发和产业化 |
| 24 | 基于光刻与电镀工艺的先进封装技术开发 |
| 25 | 3D 驱动的高精度免示教力控打磨系统研发及产业化 |
| 26 | 晶圆切割用超高精度高可靠性智能伺服电机系统研发及产业化 |
| 27 | 旋动流抗菌抗凝透析导管 |
| 28 | 面向商业航天的高性能减振技术研发及产业化 |
| 29 | 低温低压电化学合成氨技术研发及产业化 |
| 30 | 基于多源感知与非线性力学深度融合的桥梁智能监测装备与系统 |
| 31 | 基于 AI 全景技术的智能影像设备研发及产业化 |
| 32 | AI 驱动的多模态监测脑功能闭环调控系统的研发与产业化 |
| 33 | 基于 AI 的高精密多轴联动检测设备的研发及产业化 |
| 34 | 基于 Σ - Δ 架构高精度模数(AD)转换的低功耗红外传感调理芯片的研发及产业化 |
| 35 | 基于 AI 算法的重载真空搬运系统的研发及产业化 |
| 36 | 全解耦线控制动产品的研发及产业化 |
| 37 | 低插损、低钳位电压 TVS 器件的研发及产业化 |

| | |
|----|--------------------------------|
| 38 | 基于微流控芯片的自动化非侵入式单精子生化优选系统研发与产业化 |
| 39 | 基于 AI 技术的健康服务产品营销推广系统的研发及产业化 |
| 40 | 全周期全场景低空综合巡检系统的研发及产业化 |
| 41 | 基于协同仿真的高速转子-无油轴承系统的研发及产业化 |
| 42 | 面向复杂曲面的五轴智能加工装备研发与产业化 |
| 43 | 国产高精度多模态原子力显微镜研发与产业化 |
| 44 | 半导体薄膜断层吸收光谱仪的研发及产业化 |
| 45 | 过冷大水滴发生设备及云雾模拟试验系统的研发及产业化 |
| 46 | 高可靠一体注塑式储能连接器产品开发产业化 |